

治具なしウェハーでマイクロボール実装を可能に

Controls occurrence of voids by using original pure alloy processing

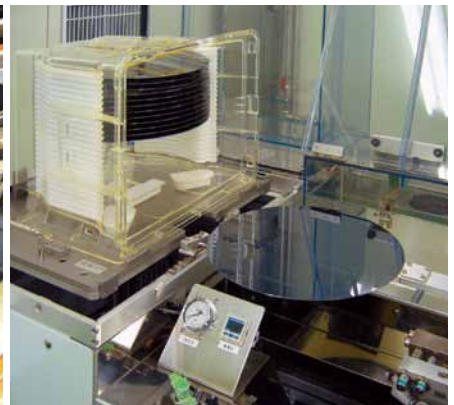
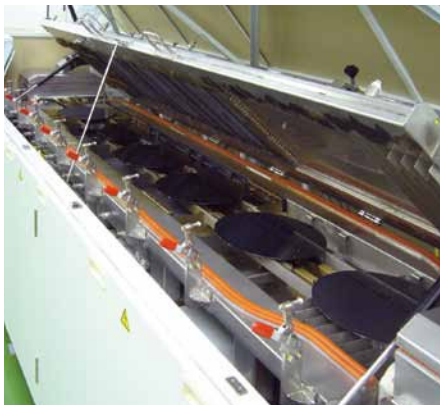
CX-430 ～φ300mmウェハー対応クリーンリフロー炉～

ウェハーレベルのソルダバンプ形成とベアチップのフェースダウン実装を可能



特長

- 300mmウェハーのバンプ形成を目的としたリフロー炉。
- 発塵しないウォーキングビーム搬送方式を用いてクラス1000を実現。
- 分割配置された輻射式ヒーターにより、300mmウェハーでの ΔT を5°C以内。
- フラックス回収機構を装備。



200及び300mmウェハーに対応